



Deutsches IMAPS-Seminar – 8. Februar 2007, TU Ilmenau

Liebe Mitglieder,

wegen geringfügiger Änderungen im Programmablauf für das Seminar in Ilmenau möchten wir an dieser Stelle nochmals die aktuelle Planung darstellen. Es soll auch nochmals speziell darauf hingewiesen werden, dass Mitglieder des *DVS* die gleichen vergünstigten Gebühren zahlen wie *IMAPS*-Mitglieder. Für Studenten gilt ein gesonderter geringer Preis. Das diesjährige Thema lautet:

FlipChip – die Alternative zum Drahtbonden?

Datum: Donnerstag, den 8. Februar 2007, Beginn: 9 Uhr

Veranstaltungsort: TU-Ilmenau, Humboldtbau, Humboldthörsaal

<i>Thema</i>	<i>Vortragender, Firma, Ort der Firma</i>
9:00	Einschreibung
9:30	Begrüßung Jens Müller, IMAPS
Podiumsvorträge	
9:40	COB versus Flip-Chip – ein Kostenvergleich Joachim Kloeser, Aemtec, Berlin
10:05	Drahtbonden stellt sich den Herausforderungen und bleibt konkurrenzfähig Martin Schneider-Ramelow, IZM, Berlin
10:30	Mikrokontaktierungsverfahren für die Systemintegration im Package Klaus-Jürgen Wolter, TU Dresden
10:55	Neues Verfahren zur Beurteilung von Ultraschallschweißverbindungen Hans J. Hesse, Hesse & Knipps, Paderborn
11:20	Kaffeepause
12:00	Podiumsdiskussion Leitung: Paradiso Coskina, VDI/VDE-IT, Berlin Teilnehmer: F. Rudolf, K.-J. Wolter, J. Kloeser, M. Schneider-Ramelow, H. J. Hesse
12:45	Mittagspause
Fachvorträge	
14:00	HF-Module und Komponenten (1 - 100 GHz): Anforderungen und Aufbauarchitekturen Martin Oppermann, EADS, Ulm
14:25	Sensorminiaturisierungen auf Basis der Flip-Chip-Technik Sabine Nieland, CiS, Erfurt
14:50	Prozesse und Anlagen zum Flip-Chip-Bonden auf Wafersubstraten Hannes Kostner, Datacon, Radfeld (A)
15:15	Hochauflösende Fehleranalyse an Chipkontaktierungen Matthias Petzold, FHG IWMH, Halle
15:40	Kaffeepause

	<i>Thema</i>	<i>Vortragender, Firma, Ort der Firma</i>
16:05	Medizinische Geräte – 7 Jahre Flip-Chip-Technik	Peter Liebisch, Biotronik, Berlin
16:30	Thermisches Management bei Flip-Chip auf LTCC	Markus Norén, Epcos, Deutschlandsberg (A)
16:55	Bonden mit Bändern – Neues vom Dickdrahtbonden bei Leistungsbau-elementen	Josef Sedlmayr, F & K Delvotek, Ottobrunn
17:20	Drahtbonden in der Zukunft: Potenziale – Perspektiven – Visionen	Tobias Müller, Heraeus, Hanau
17:45	Micro Ball Placement für Wafer Level CSP	Thomas Oppert, Pactech, Nauen
18:10	Schlussworte	Jens Müller, IMAPS

Teilnehmergebühren:

Mitglieder von IMAPS und DVS: 110,- €, Nichtmitglieder: 160,- €, Studenten: 30,- €

In der Teilnehmergebühr sind die Proceedings auf CD, Mittagessen und Pausenkaffee enthalten.

Pressemitteilung zur Kooperation IMAPS – CPMT (IEEE)

Nach einer Zeit fruchtbarer Verhandlungen sind die *IMAPS Europa* und die *CPMT – Components, Packaging and Manufacturing Technologies* des *IEEE* übereingekommen, in Europa zusammenzuarbeiten und damit ihren Mitgliedern ein verbessertes Angebot zur Verfügung zu stellen.

Seit Oktober 2006 bringt diese Zusammenarbeit ein Netzwerk hervor, das die Interessen der Industrie und das Wissen der F&E-Landschaft nutzbringend verbindet. Eine Vielzahl von Aktivitäten und Veranstaltungen für die *Packaging und Mikroelektronik*-Gemeinschaft wird so durch beide Organisationen gemeinschaftlich angeboten und organisiert werden können, da die Interessen ähnlich gelagert sind.

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden führenden Verbänden in Europa ist in einem „Memorandum of understanding“ dargelegt. Mitglieder beider Organisationen werden Nutzen von dieser Zusammenarbeit haben. *Paul Collander*, der Präsident der *IMAPS Europa*, hofft, dass „die Mitglieder aus Industrie, Forschung und Entwicklung das gemeinsame Veranstaltungsmanagement, das die Kooperation bieten soll, schätzen lernen werden.“

Die jeweiligen Konferenzen *EPMC* der *IMAPS* und *ESTC* der *CPMT* werden abwechselnd in den geraden bzw. ungeraden Jahren stattfinden, um der gemeinschaftlichen Vorbereitung, Teilnahme etc. Rechnung zu tragen.

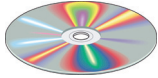
Weiterführende Informationen können den Webseiten www.imapseurope.org und www.cpmc.org entnommen werden. Sie können sich gern auch mit Fragen an Herrn *Aschenbrenner* (aschenbr@ieee.org) oder Herrn *Collander* (president.elc@imapseurope.org) wenden.

Veranstaltungskalender

<i>Ort</i>	<i>Zeitraum</i>	<i>Name</i>	<i>Veranstalter</i>
La Rochelle	31.1./1.2.2007	2 nd European Advanced Technology Workshop	iMAPS France
Ilmenau	8.2.2007	„On Micropackaging and Thermal Management“	iMAPS D
		iMAPS D-Seminar Ist FlipChip eine Alternative zum Drahtbonden?	
Daventry, Northampton, UK	6./7.3.2007	MicroTech Conference 2007	iMAPS UK
Denver, Colorado	23./26.4.2007	IMAPS / ACerS 3. Konferenz für CICMT (Ceramic Interconnect and Ceramic Microsystems Technology)	IMAPS Nordamerika / Amerikanische Keramische Gesellschaft ACerS
Oulu, Finnland	17./20.6.2007	EMPC 2007 – 16 th European Microelectronics and Packaging Conference & Exhibition	IMAPS Nordic / Europa
München	8./9.10.2007	IMAPS Konferenz 2007	iMAPS D

Noch zu haben: Proceedings

Die Proceedings des *Deutschen IMAPS-Seminars 2006*, das am 9. Februar 2006 in Göppingen zum Thema *Muss jeder Sensor smart sein?* stattfand, können auf CD zum Preis von



€ 55,-

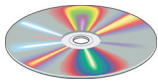
und als Papierausdruck zum Preis von



€ 110,-

erworben werden.

Auch die Proceedings der *Herbsttagung 2006*, die am 10. und 11. Oktober 2006 in München durchgeführt wurde, sind jetzt als CD zum Preis von



€ 55,-

erhältlich.

Richten Sie bitte Ihre Bestellungen an:

Prof. Dr. Wolfgang Radlik, c/o FH Rosenheim, Hochschulstraße 1, D-83024 Rosenheim, Fax 08031/805-603, wolfgang.radlik@imaps.de

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß § 4 Nr. 22 UstG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

Internet-Auftritt von IMAPS Deutschland

Sie finden die Webseiten von IMAPS Deutschland im Internet unter

<http://www.imaps.de>

Hier erhalten Sie aktuelle Informationen über Veranstaltungen und Ansprechpartner von *IMAPS Deutschland e.V.* Darüber hinaus können Sie dort auch Ihre Mitgliedschaft beantragen. Über Kritik und Anregungen, aber auch inhaltlichen Input würde sich der Vorstand sehr freuen.

Die internationalen Seiten von IMAPS erreichen Sie unter

<http://www.imaps.org>

oder für Europa:

<http://www.imapseurope.org>

Kontakte und Adressen des IMAPS-Vorstandes

Dr.-Ing. Jens Müller
1. Vorsitzender
c/o ZiK MacroNano
Applikationszentrum Ilmenau
Gustav-Kirchhoff-Str. 5
98693 Ilmenau

Fon: 03677/69-3381
Fax: 03677/69-3379
e-mail: jens.mueller@imaps.de

Dr.-Ing. Gisela Dittmar
2. Vorsitzende
c/o Ingenieurbüro Elektroniktechnologie
Egerlandstraße 88
D-73431 Aalen
Fon: 07361/931129
Fax: 07361/943004
e-mail: gisela.dittmar@imaps.de

Prof. Dr. Wolfgang Radlik
Schatzmeister
c/o FH Rosenheim
Hochschulstraße 1
D-83024 Rosenheim
Fon: 08031/805-629
Fax: 08031/805-603
e-mail: wolfgang.radlik@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Matthias Fischer
Schriftführer
c/o FH Schmalkalden
FB Elektrotechnik
D-98574 Schmalkalden
Fon: 03683/688-5116
Fax: 03683/688-5499
e-mail: matthias.fischer@imaps.de

Dipl.-Phys. Rolf Aschenbrenner
Öffentlichkeitsarbeit
c/o Fraunhofer Institut Zuverlässigkeit
und Mikrointegration
Chip Interconnection Technologies
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
Fon: 030/46403-164
Fax: 030/46403-161
e-mail: rolf.aschenbrenner@imaps.de

Dipl.-Ing. Thomas Bartnitzek
Öffentlichkeitsarbeit
c/o VIA electronic GmbH
Robert-Friese Straße 3
D-07629 Hermsdorf
Fon: 036601/81-529
Fax: 036601/81-530
e-mail: thomas.bartnitzek@imaps.de

Dipl.-Ing. Paradiso Coskina
Öffentlichkeitsarbeit
c/o VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Steinplatz 1
D-10623 Berlin
Fon: 030/310078-242
Fax: 030/310078-256
e-mail: paradiso.coskina@imaps.de

Dr.-Ing. Karl-Heinz Drüe
Öffentlichkeitsarbeit
c/o TU Ilmenau
Fakultät EI
FG Mikroperipherik
Pf 100565

D-98684 Ilmenau
Fon: 03677/69-3429
Fax: 03677/69-3350
e-mail: karl-heinz.drue@imaps.de

Ernst Eggelaar
Öffentlichkeitsarbeit
c/o Microtronic Microelectronic Vertriebs GmbH
Klein Grötzing

D-84494 Neumarkt-St. Veit
Fon: 08722/9620-0
Fax: 08722/9620-30
e-mail: ernst.eggelaar@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Heinz Osterwinter
Öffentlichkeitsarbeit
c/o FHTE Standort Göppingen
Robert-Bosch-Str. 1
D-73037 Göppingen
Fon: 07161/679-157
Fax: 07161/679-233
e-mail: heinz.osterwinter@imaps.de

Dr. Martin Oppermann
Öffentlichkeitsarbeit
EADS Deutschland GmbH
Microwave Factory / Defence Electronics
Woerthstr. 85
D-89077 Ulm
Fon: 0731/392-3879
Fax: 0731/392-3362
e-mail: martin.oppermann@imaps.de

Dampfphasenlöten

Von Wolfgang Leider. Erste Auflage 2002. 152 Seiten mit 130 Abbildungen und 17 Tabellen.
ISBN 3-87480-178-0. Preis € 58,- inkl. MwSt., zuzüglich Porto

Das Thema Dampfphasenlöten wurde in der Literatur bisher sehr spärlich behandelt. Das Buch soll grundlegend und umfassend über den Prozess informieren, der insbesondere im Hinblick auf die steigende Komplexität elektronischer Flachbaugruppen und ihre geforderte Bleifreiheit als Verbindungsverfahren in der Elektronik immer interessanter wird.

Die Ausarbeitung beschäftigt sich in den ersten Kapiteln mit Grundlagen, die zum Verständnis des Verfahrens beitragen und mit der aktuellen Situation in der SMT-Produktion. Ab Kapitel 12 werden Erfahrungen dargestellt, die der Autor während der Evaluierung des Verfahrens bei der Siemens AG gesammelt hat. Das macht das Buch für alle diejenigen besonders interessant, die erwägen, Dampfphasenlöten in den Fertigungsprozess einzuführen.

Eugen G. Leuze Verlag KG

Karlstraße 4 · D-88348 Bad Saulgau · Tel. 07581/4801-0 · Fax 07581/4801-10
e-mail: brigitte.brotzer@leuze-verlag.de · Internet: www.leuze-verlag.de